

米韓「7,000 億ドル AI 連合」と日本企業への影響

サンフランシスコ米韓テックサミット（2026 年 7 月 24 日）の事実整理と考察

作成日：2026 年 7 月 26 日

Claude Opus 5

1. 何が起きたか（事実整理）

1-1. サミットの概要

2026 年 7 月 24 日、サンフランシスコで韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が主催した米韓テックサミットが開催された。参加者は約 150 名の経営者・投資家・研究者・スタートアップ創業者[3]。李大統領は韓国を AI 市場の「グローバルハブ」と位置づけ、成果文書として「サンフランシスコ AI 宣言」を発表した[1][2][4]。

米国側	韓国側
ジェンソン・フアン（NVIDIA CEO）	李在鎔（サムスン電子 会長）
サム・アルトマン（OpenAI CEO）	崔泰源（SK グループ 会長）
ダリオ・アモデイ（Anthropic CEO）	鄭義宣（現代自動車グループ 会長）
ホック・タン（Broadcom CEO）	李海珍（ネイバー 創業者）

出所：Reuters[3]、The Korea Herald[7]

1-2. 主な合意・発表

- **NVIDIA × SK グループ：5,000 億ドル超**の次世代 AI インフラ提携枠組み。SK テレコムが NVIDIA「Vera Rubin」とSK ハイニックス「HBM4」を採用した **2GW 級 AI データセンター**を建設し、**2027 年稼働**を目指す[3][4]。
- **Anthropic** がサムスン電子・SK ハイニックスと**メモリ供給契約**を締結。崔泰源会長は「AI 顧客が求めるメモリ量は従来想定をはるかに超えている」と述べた[3]。
- **NVIDIA** は韓国全土に **25 万基の GPU** を配備する方針を示し、KAIST（韓国科学技術院）と共同 AI 研究所を設立した。韓国の大学と海外テック企業による初の共同ラボとなる[5][6]。

- 背景には、韓国政府が 2026 年 6 月 29 日に発表した「**3 大メガプロジェクト**」＝約 5,760 億ドルの官民投資（①半導体、②ハイパースケール AI データセンター、③フィジカル AI）がある [4][8]。

1-3. 韓国側の国内投資計画（サミットの土台）

項目	規模	時期・備考
サムスン電子+SK ハイニックスのメモリ投資	800 兆ウォン（約 84 兆円） 新工場 4 棟	5 年で DRAM 能力を 2 倍化。光州に新ファブ、龍仁クラスターを前倒し、清州に HBM/NAND 施設
AI データセンター 第 1 期	550 兆ウォン／8.4GW	2029 年まで
AI データセンター 第 2 期（累計）	1,000 兆ウォン超／18.4GW	2035 年まで
政府の電力・用水コミット	DC 向け 8GW 超 首都圏ファブ 15GW+用水 150 万トン 南西部ファブ 6.3GW+用水 65 万トン	特別法に基づく

特別法により、送電線の地中化・工業用水リサイクル設備・再生可能エネルギー設備などの**インフラ整備費を最大 100%国費負担**とすることが明記された。あわせて AI データセンター専用の電力料金メニュー、ワンストップの行政手続きも用意されている [9][10][11]。

【数字の読み方に注意】

「7,000 億ドル（約 110 兆円）」は個別の新規資金ではなく、既発表の国家プロジェクト（5,760 億ドル）と企業間 MOU（NVIDIA-SK の 5,000 億ドル枠組み等）を積み上げた総額とみられ、

同じデータセンター投資を複数の角度から数えている重複計上の可能性が高い。内訳の公式開示はない。また多くは法的拘束力のない MOU であり、実行は電力・資金・需要の 3 条件次第である [1][2]。

2. 日本の立ち位置（比較）

	韓国	日本
公的支援の枠組み	インフラ費を最大 100%国費負担（特別法）	2030 年度まで公的支援 10 兆円超／官民投資 50 兆円超 [31]
単年の政府予算	（非開示）	経産省 2026 年度 AI・半導体予算 1 兆 2,390 億円（前年度当初比 3.7 倍）、うちラピダス約 7,800 億円 [32][35]

	韓国	日本
先端ロジック	(TSMC・サムスンに依存)	ラピダス 2nm、累計支援約 2.9 兆円、量産目標 2027 年度後半。量産顧客は未確定[33][34]
メモリ	DRAM 能力 2 倍化、HBM 主導[9]	マイクロン広島 1.5 兆円 (1γ DRAM+HBM、補助最大 5,000 億円)、キオクシア FY26-28 で約 1.4 兆円 [36][39][40]
AI データセンター	2035 年に 18.4GW[10]	NTT が 2033 年度に 1GW、ソフトバンク堺 150～250MW。全国の DC+ファブ需要増は 2034 年度で約 7.2GW[41][42][43]
電力系統接続	政府が需要地まで供給を約束	千葉・印西などで受電開始まで最大 10 年待ち。需要は東京圏に 62%集中[43][44]

構図：日本は「素材・装置・製造技術」で強く、韓国は「メモリ本体・AI インフラ・国家動員力」で先行している。今回の合意はこの非対称性をさらに強める方向に働く。

3. 日本企業への影響

3-1. 【強い追い風】半導体製造装置・後工程材料

韓国の DRAM/HBM 投資は、日本の装置・材料メーカーにとって過去最大級の需要源となっている。

- **SEAJ 予測 (2026 年 7 月 2 日)：**日本製半導体製造装置の販売高は FY2026 が **6 兆 5,502 億円 (+26.0%)**、FY2027 が **7 兆 4,017 億円 (+13.0%)**。2026 年 1 月版 (約 5.5 兆円) から **半年で約 1 兆円の上方修正**となり、理由は明確に「HBM を中心とした DRAM 投資の大幅増加」とされた[12][13]。
- **SEMI：**2026 年の世界装置市場は 1,659 億ドル (+23.2%)、うち **DRAM 向け WFE は 388 億ドル (+39.0%)**と突出している[14]。

重要な構造：HBM は「装置インテンシティ」が異常に高い。HBM は DRAM ウェハ容量の **22%** (2026 年末見込み) を占めるのに、ビット供給では **9%**にすぎない。同じ 1 ビットを作るのに約 2.4 倍の工程が必要で、これが日本製装置・材料需要のレバレッジ源になっている[28]。

■ 韓国向け売上比率 (FY2026 実績)

企業	韓国比率	補足
東京エレクトロン	22.3%	実質サムスン+SK ハイニックスの2社。日本の装置大手で最も韓国感応度が高い。Si エッチング約 90%=TSV 形成の要[16][17]
TOWA	11.2%	圧縮成形装置シェア 63~70%。受注 595.6 億円 (+25.6%) [21]
ディスコ	7.6%	直販比率は低いがグラインダ約 80%/ダイサ約 70%で HBM 薄化の最終受益者。HBM4 は 30 μ m まで薄化[19]
SCREEN	約 7% (SPE 事業)	前年 5%から上昇[20]
アドバンテスト	非開示	FY2026 営業利益+118.8%。HBM は積層前後で複数回のテストが必要[18]
レーザーテック	非開示	受注予想を 2,000~2,400 億円へ上方修正

■ 材料側の寡占ポジション

- **レゾナック**：NCF・DAF・CMP スラリーで世界 1 位。NCF 能力を 3.5~5 倍へ増強（投資 150 億円）[22]。
- **ナミックス**：MR-MUF 封止材を SK ハイニックスに独占供給[26]。
- **味の素**：ABF フィルム約 95%（AI データセンター用途はほぼ 100%）。ただし HBM 本体ではなく GPU 側パッケージ基板向け[23]。
- **東京応化工業**：レジスト世界首位 24.7%。韓国・平澤に約 120 億円を投資し 2027 年下期稼働予定[25]。
- **信越化学+SUMCO**：シリコンウェハで世界合計約 6 割。ただし信越は「HBM 向けは 300mm ウェハ市場の 5%強」と明言しており、数量寄与は限定的[24]。

追い風が延びた要因：ハイブリッドボンディング（HCB）への移行が後ろ倒しになった。JEDEC の厚さ規格緩和（720→775 μ m）もあり、HCB 採用は**最速で HBM4E 16 段、サムスンの本格量産は 2029~2030 年**へずれ込む見通しである。結果として **NCF/MR-MUF/モールド系（レゾナック・ナミックス・TOWA）の受益期間が 3~4 年延長された**[26][27][29]。

3-2. 【逆風・構造リスク】「装置本体」で締め出される領域

追い風の裏で、日本勢が一度失った領域は戻ってこないという先例が積み上がっている。

- **TC ボンダー（HBM 積層の中核装置）**：韓国ハンミ半導体 71.2%、セメス 13.1%に対し、新川（ヤマハロボティクス）はわずか 5.6%。日本勢が実質敗退した領域である[30]。
- **HCB ボンダー本体**：オランダ BEI が主導（1 台約 430 万ドル）。キヤノンマシナリーは 2026 年以降の実用化予定で出遅れている[29]。

- **EUV**：ASML の韓国向け比率は 2026 年 1～3 月期に 45%（SK ハイニックスが約 69 億ユーロ発注）。投資増分の果実は ASML に偏る[47]。
- **価格交渉力**：SK ハイニックスは平時「追加発注のたびに約 10%値下げ」「協力会社は 5 年余り値上げゼロ」という慣行を持つ。2026 年に 3～4%の値上げが通ったのは市況起因の一時的現象とみるべきである[46]。
- **輸出規制の傷跡**：2019 年の対韓輸出規制は 2023 年に解除されたが、フッ化水素の対韓輸出は今も規制前の約 20%水準にとどまる。韓国の国産化・調達分散は不可逆である[48]。

示唆：日本勢の強みは「工程（薄化・テスト・エッチング・封止材）」に集中しており、**装置システムの上位レイヤーは韓国・欧州に取られつつある**。HBM4 から HBM4E への世代交代で、この構図がさらに固定化するかが分水嶺となる。

3-3. 【競合激化】メモリ本体：キオクシア・マイクロン広島

- **NAND シェア（2026 年 Q1）**：サムスン 29%、SK ハイニックス 18%、キオクシア 14～20%（推計に幅）、マイクロン 13%、SanDisk 13%、YMTC 13%[38]。
- 韓国勢が DRAM 能力を 5 年で 2 倍にする過程で、ウェハ・材料・装置・クリーンルーム人材の**取り合い**が起き、キオクシアの調達リードタイムとコストに悪影響が出る可能性がある[9]。
- 一方でキオクシアは FY2026 に初の売上 2 兆円超（営業利益 7,545 億円、+67%）を達成し、データセンター／エンタープライズ SSD が売上の約 6 割を占める。FY26-28 で 3 年約 1.4 兆円の設備投資を計画し、北上第 3 棟を検討中である[36][37]。サンディスクと共同開発中の HBF（高帯域フラッシュ）が立ち上がれば「HBM の隣」でポジションを取れる可能性があるが、商用化時期は不確実である。
- **マイクロン広島**（1.5 兆円、2026 年 7 月 4 日起工、装置搬入 2028 年後半）は 1γ DRAM+HBM 向けで、1γ への EUV 適用は世界初となる。材料の約 8 割が日本製であり、日本国内に HBM サプライチェーンが立ち上がる意義は大きい。ただし装置搬入が 2028 年後半で、**韓国の 2027 年稼働に対し 1 年以上の出遅れ**となる[39][40]。

3-4. 【最大の構造課題】AI データセンター誘致と電力

ここが日本にとって最も不利な戦線である。

	韓国	日本
2035 年目標	18.4GW[10]	明示的な国家目標なし（DC+ファブの需要増が 2034 年度で約 7.2GW）[43]

	韓国	日本
政府コミット	電力・工業用水を政府が需要地まで供給、インフラ費最大 100%国費	補助金中心。系統接続は事業者責任[31]
接続待ち	ワンストップ行政で短縮	印西などで最大 10 年[44]
電気料金	AIDC 専用料金を新設	一般料金

NVIDIA・OpenAI・Anthropic といった **AI 需要の発注元が「韓国に置く」判断をした**という事実が重い。日本のデータセンター事業者（NTT、ソフトバンク、KDDI、さくらインターネット）にとっては、アジアの AI インフラ拠点競争で韓国に先行されるリスクとなる[3][5][41][42]。日本の AI 利用企業にとっても、国内で計算資源が確保できず海外リージョン依存が続くことは、データ主権・レイテンシ・コストの不利を固定化させかねない。

3-5. 【新戦線】フィジカル AI：現代自動車 対 日本の製造業

3 大メガプロジェクトの第 3 の柱が「**フィジカル AI**」（ロボット・自動運転・産業自動化）であり、サミットには鄭義宣・現代自動車会長が出席した[3][8]。NVIDIA のロボティクス基盤と韓国の製造基盤を組み合わせる構図である。

- 対象となる日本企業：トヨタ、ホンダ、ファナック、安川電機、キーエンス、オムロン、川崎重工など。
- 日本は個社の技術力は高いが、「国家×GPU ベンダー×完成車メーカー」を束ねたフィジカル AI 基盤という座組では韓国が先行している。
- 産業用ロボットで日本は世界シェア約半分を握るが、**AI 基盤層を海外に握られると付加価値が上流に吸い上げられる**構図となる（スマートフォンにおける日本の部品メーカーの経験の再現リスク）。

3-6. 【地政学】日本は米中韓に挟まれる

- **中国の対日措置が同時進行**：ガリウム・ゲルマニウムの対日輸出が 2026 年 1～2 月にゼロとなった[49]。対日エンティティリストは計 80 社（2026 年 2 月・6 月の 2 波、第 2 波では材料サプライヤーも対象）に及び、再輸出条項により日本国内取引でも抵触しうる。
- 日本の装置大手 5 社の FY2025 中国売上は 1 兆 4,700 億円で史上初の▲12%減。中国の装置国産化率は 2018 年 4%→2025 年 21%へ上昇した[45][50]。
- **中国で減った分を韓国で埋めている構造**である。つまり日本の装置・材料産業の韓国依存は「積極的」というより「消極的に」高まっており、韓国が国産化を進めれば逃げ場がない。

4. リスク：この追い風はいつまで続くか

リスク	内容
投資サイクルのピークアウト	SEMI の DRAM 向け装置投資の伸びは 2026 年+15.1%→2027 年+7.8%へ減速見通し。モルガン・スタンレーは業績上方修正比率 89%を「余地枯渇シグナル」とし、2026 年下期をリスクウィンドウと指摘[14][51]
新工場の寄与は 2027 年後半以降	800 兆ウォン投資の本格寄与は 2027 年後半から。2026 年度は平沢 P4 のランプアップと既存ラインの微細化投資が主であり、「発表＝即受注」ではない[9][11]
MOU の実行率	7,000 億ドルの多くは拘束力のない MOU。韓国側の電力調達・資金調達・人材確保が制約となる[1][3]
需要の前提	すべては AI 設備投資が続く前提。ハイパースケーラーの投資減速があれば真っ先に削られるのはメモリ増設である

5. まとめ：日本企業への示唆

短期（～2027 年）：明確なプラス

半導体製造装置・後工程材料が最大の受益者となる。SEAJ が半年で 1 兆円上方修正した通り、韓国の HBM/DRAM 投資は日本の装置・材料需要を直接押し上げる[12][13]。HCB 移行の後ろ倒しにより、NCF・MR-MUF・モールド系の受益期間もさらに 3～4 年延びた[26][27]。

中期（2028 年～）：ポジション次第で明暗

勝ち筋は「HBM の工程で代替不能な位置を持つか」に尽きる。ディスコ（薄化）、東京エレクトロン（TSV エッチング）、アドバンテスト（テスト）、レゾナック・ナミックス（封止材）、味の素（ABF）は方式が変わっても残る。逆に、TC ボンダーで新川が 5.6%まで落ちたように、**装置システム**の上位レイヤーは着実に奪われている[30]。

長期：本丸は「AI インフラ立地競争」で日本が負けつつあること

韓国が 2035 年 18.4GW を国費で支えると宣言したのに対し[10]、日本は系統接続に最大 10 年かかる[44]。素材・装置で稼いでも、**AI そのものを動かす場所が国内になれば、AI の付加価値は国外に落ちる**。日本にとっての本当の論点は「装置株が上がるか」ではなく、**電力・系統・立地というインフラ政策を、韓国並みの国家コミットに引き上げられるか**にある。

■ 具体的に注視すべき指標

1. SEAJ 需要予測の次回改定（2027 年度見通しの上下）[12]
2. 東京エレクトロン・TOWA の韓国向け比率（22.3%/11.2%からの推移）[16][21]

3. HBM4E 世代での HCB 採用時期の前倒し／後ろ倒し[26][27]
4. マイクロン広島 of 装置搬入スケジュール（2028 年後半）が守られるか[39]
5. ラピダスの量産顧客の確定有無（2027 年度後半量産に向けて）[33][34]
6. 日本 of DC 系統接続の改善策（AIDC 向け特別料金・接続優先枠の導入有無）[43][44]

参考文献

本文中の [n] は以下の番号に対応する。最終アクセス日：2026 年 7 月 26 日。

- [1] Nikkei Asia, "Samsung, SK and Nvidia join \$700bn US-Korea AI push"
<https://asia.nikkei.com/business/technology/artificial-intelligence/samsung-sk-and-nvidia-join-700bn-us-korea-ai-push>
- [2] 日本経済新聞「米韓テック、110 兆円の AI 協業 サムスン・SK やエヌビディア」2026 年 7 月 25 日
<https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM250LJ0V20C26A7000000/>
- [3] Reuters / The Star, "South Korea President Lee hosts US tech summit, calls for new AI era", 2026 年 7 月 25 日 <https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2026/07/25/south-korea-president-lee-hosts-us-tech-summit-calls-for-new-ai-era>
- [4] StratNews Global, "South Korea Unveils AI Push as Lee Courts Nvidia, OpenAI and Samsung"
<https://stratnewsglobal.com/world-news/south-korea-unveils-ai-push-as-lee-courts-nvidia-openai-and-samsung/>
- [5] NVIDIA Blog, "At AI Summit, South Korea Outlines Its AI Future With NVIDIA and Partners"
<https://blogs.nvidia.com/blog/ai-summit-korea-partners-and-nvidia/>
- [6] Korea Economic Institute of America (KEIA), "What the San Francisco AI Summit Means for U.S.-Korea Tech Cooperation" <https://keia.org/analysis/what-the-san-francisco-ai-summit-means-for-u-s-korea-tech-cooperation/>
- [7] The Korea Herald, "Lee takes Korea's AI ambitions to Silicon Valley", 2026 年 7 月 22 日
<https://www.koreaherald.com/article/10816887>
- [8] Crypto Briefing, "South Korea's President Lee hosts US tech summit, signals massive AI and semiconductor push" <https://cryptobriefing.com/south-korea-us-ai-summit-semiconductor-push/>
- [9] ビジネス+IT「韓国サムスンと SK ハイニックス、DRAM 半導体分野へ約 84 兆円の巨額投資計画を発表」
<https://www.sbbi.jp/article/st/185948>
- [10] BigGo ファイナンス「韓国政府、AI データセンターに約 104.7 兆円の官民投資…2035 年までに 18.4GW 構築へ」
<https://finance.biggo.jp/news/157408e1-48e4-4bd5-a254-c912fc55faf8>
- [11] 日本経済新聞「サムスン・SK、83 兆円で 4 工場」
<https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM265UK0W6A620C2000000/>
- [12] SEAJ（日本半導体製造装置協会）「2026 年 7 月 日本製半導体製造装置販売高予測」
https://www.seaj.or.jp/file/july2026seajforecastforpress_j.pdf
- [13] SEAJ「2026 年 1 月 日本製半導体製造装置販売高予測」
https://www.seaj.or.jp/file/jan2026seajforecastforpress_j.pdf
- [14] SEMI, "Global Semiconductor Equipment Sales Forecast to Reach a Record \$229 Billion in 2028"
<https://www.semi.org/en/semi-press-release/global-semiconductor-equipment-sales-forecast-to-reach-a-record-229-billion-dollars-in-2028-semi-reports>
- [15] SEMI, "Global Semiconductor Equipment Billings Reached \$135 Billion in 2025"（地域別実績）
<https://www.semi.org/en/SEMI-Reports-Global-Semiconductor-Equipment-Billings-Reached-135-Billion-in-2025>
- [16] 東京エレクトロン「2026 年 3 月期 決算短信」 <https://www.tel.co.jp/ir/irta3a00000006g5-att/fy26q4tanshin-j.pdf>

- [17] 東京エレクトロン「FY2026 Q4 決算説明会 トランスクリプト」（地域別売上内訳）
<https://www.tel.com/ir/library/report/pjuomj00000000tf-att/fy26q4transcript-e.pdf>
- [18] アドバンテス「2026 年 3 月期 決算短信」 https://www.advantest.com/ja/news/2026/a81o6o0000000heh-att/J_FR_FY2025_FN.pdf
- [19] ディスコ「2026 年 3 月期 決算短信」 <https://www.disco.co.jp/jp/ir/library/doc/fr/fr20260422.pdf>
- [20] SCREEN ホールディングス「FY2026 Q4 決算説明会資料」 https://hdjp-corporateweb-files.screen.co.jp/8617/7865/4152/FY2026Q4_Mtg_J.pdf
- [21] TOWA「2026 年 3 月期 有価証券報告書」 https://www.towajapan.co.jp/jp/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/2025FY_annual.pdf
- [22] レゾナック・ホールディングス「2025 年 12 月期 決算説明資料」
<https://www.resonac.com/sites/default/files/2026-02/shiryo2025q4.pdf>
- [23] 味の素「FY25 Q4 決算説明資料」
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/event/presentation/main/011111114/teaserItems1/00/linkList/03/link/FY25_Q4_Presentation_J.pdf
- [24] 信越化学工業「2026 年 1 月 27 日 決算説明会サマリー」（HBM 向けウェハは 300mm 市場の 5%強）
https://www.shinetsu.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/20260127_summary_J.pdf
- [25] 東京応化工業「韓国・平澤工場の新設について」 https://www.tok.co.jp/news/2025/250806_5
- [26] TrendForce, "Samsung, SK hynix Reportedly Reconsider Hybrid Bonding Timeline", 2026 年 7 月 7 日
<https://www.trendforce.com/news/2026/07/07/news-samsung-sk-hynix-reportedly-reconsider-hybrid-bonding-timeline-16-high-hbm4e-may-be-earliest-adoption/>
- [27] TrendForce, "Samsung Reportedly Builds Hybrid Bonding Mass Production Line", 2026 年 7 月 22 日
<https://www.trendforce.com/news/2026/07/22/news-samsung-reportedly-builds-hybrid-bonding-mass-production-line-full-scale-deployment-seen-in-2029-2030/>
- [28] TrendForce「HBM のウェハ容量シェア 22%対ビット供給 9%」 2026 年 6 月 2 日
<https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260602-13074.html>
- [29] Semiconductor Engineering, "HBM4 Sticks With Microbumps, Postponing Hybrid Bonding"
<https://semiengineering.com/hbm4-sticks-with-microbumps-postponing-hybrid-bonding/>
- [30] SisaJournal-e（TechInsights 引用）「TC ボンダー市場シェア：ハンミ 71.2%、セメス 13.1%、新川 5.6%」 <https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=417986>
- [31] 経済産業省「AI・半導体産業基盤強化フレーム」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/ai_semiconductor_frame/ai_semiconductor_frame.html
- [32] 内閣府・経済産業省「第 1 回 AI・半導体ワーキンググループ 事務局説明資料」 2026 年 2 月 12 日
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/seichosenryakuwg/aisemicon01/shiryo04.pdf
- [33] 日本経済新聞「ラピダスに追加支援 1 兆円 政府、累計 2.9 兆円」
<https://www.nikkei.com/article/DGKKZ092761840R21C25A1EA5000/>
- [34] Rapidus, "Rapidus Secures 267.6 Billion Yen in Funding from Japan Government and Private Sector Companies" https://www.rapidus.inc/en/news_topics/information/rapidus-secures-267-6-billion-yen-in-funding-from-japan-government-and-private-sector-companies/

- [35] 北海道新聞「ラピダス支援に 7800 億円 経産省 26 年度予算案」 <https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1257606/>
- [36] TrendForce, "Kioxia Targets ¥470B Yearly Capex in FY26–28, Up 66% from FY25", 2026 年 6 月 3 日 <https://www.trendforce.com/news/2026/06/03/news-kioxia-targets-%C2%A5470b-yearly-capex-in-fy26-28-up-66-from-fy25-reportedly-weighing-third-kitakami-fab-and-ma/>
- [37] SeizoTrend / ビジネス + IT「キオクシア HD 2026 年 3 月期決算」 <https://www.sbbi.jp/article/st/181016>
- [38] Counterpoint Research, "Global NAND Memory Market Share: Quarterly" <https://counterpointresearch.com/en/insights/global-nand-memory-market-share>
- [39] TrendForce, "Micron Breaks Ground on Hiroshima Fab Expansion", 2026 年 7 月 6 日 <https://www.trendforce.com/news/2026/07/06/news-micron-breaks-ground-on-hiroshima-fab-expansion-scaling-1%CE%B3-dram-and-hbm-output-as-equipment-set-for-2h28/>
- [40] The Japan Times, "Micron breaks ground on \$9 billion western Japan plant expansion", 2026 年 7 月 4 日 <https://www.japantimes.co.jp/business/2026/07/04/tech/micron-hiroshima-chip-plant/>
- [41] ITmedia「NTT、データセンターを 3 倍に増強へ」 2026 年 4 月 28 日 <https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2604/28/news064.html>
- [42] ソフトバンク「AI データセンター構築に向けたシャープ堺工場の取得について」 https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2025/20250314_01/
- [43] 電力広域的運営推進機関（OCCTO）「2026 年度 全国及び供給区域ごとの需要想定」 https://www.occto.or.jp/assets/news/juyousoutei/260121_juyousoutei_r1.pdf
- [44] 「AI のボトルネックは電力 — 日本のデータセンター電力需要と電源確保」（系統接続待ちの実態） <https://zenn.dev/kakuremi/articles/ai-datacenter-power-japan-2026>
- [45] TrendForce, "Top Five Japanese Chip Toolmakers Reportedly See 10%+ China Sales Drop in FY25", 2026 年 6 月 22 日 <https://www.trendforce.com/news/2026/06/22/news-top-five-japanese-chip-toolmakers-reportedly-see-10-china-sales-drop-in-fy25-led-by-front-end-weakness/>
- [46] 電子新聞（etnews）「SK ハイニックスの価格切り下げ慣行と 2026 年の値上げ要請」 2026 年 6 月 10 日 <https://www.etnews.com/20260610000340>
- [47] 電子新聞（etnews）「装置ビッグ 3 の韓国売上比率：ASML 45%」 2026 年 4 月 24 日 <https://www.etnews.com/20260424000210>
- [48] 日本総合研究所「対韓輸出管理と素材産業への影響」（フッ化水素の対韓輸出は規制前の約 2 割） <https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=36627>
- [49] South China Morning Post, "China cuts exports of two hi-tech metals to Japan" <https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3347567/china-cuts-exports-two-hi-tech-metals-japan-increases-rare-earth-shipments>
- [50] BigGo Finance「中国の半導体製造装置 国産化率 21%」 <https://finance.biggo.com/news/71354c86-2831-4eed-be01-cc593e5faf88>
- [51] BigGo Finance「モルガン・スタンレー：業績上方修正比率 89%は "peak rate of change" シグナル」 <https://finance.biggo.com/news/786cee3c-9c7f-4ae9-8e91-0e9324ace6c7>

付記：数値の確度について

- **7,000 億ドル／110 兆円**：Nikkei Asia・日経の見出し数値[1][2]。内訳の公式開示はなく、既発表分の積み上げ・重複計上の可能性がある。
- **NVIDIA-SK の 5,000 億ドル超**：提携「枠組み」の規模であり、確定投資額ではない[3][4]。
- **HBM 向け売上比率**：開示している日本企業は皆無（最も近いのはレゾナックの「後工程材料の AI 向け 20%」[22]）。装置・材料のシェア数値の大半は第三者推計である。
- **韓国向け売上比率**：東京エレクトロン、TOWA、ディスコ、SCREEN は各社 IR 開示ベース [16][19][20][21]。アドバンテスト、レーザーテック、KOKUSAI ELECTRIC は韓国向け比率を非開示。
- **ソフトバンク堺の投資額**：GPU 調達込みで 1 兆円規模との観測があるが、公式発表はない[42]。
- **NAND シェア**：推計機関により 14～20%と幅がある[37][38]。